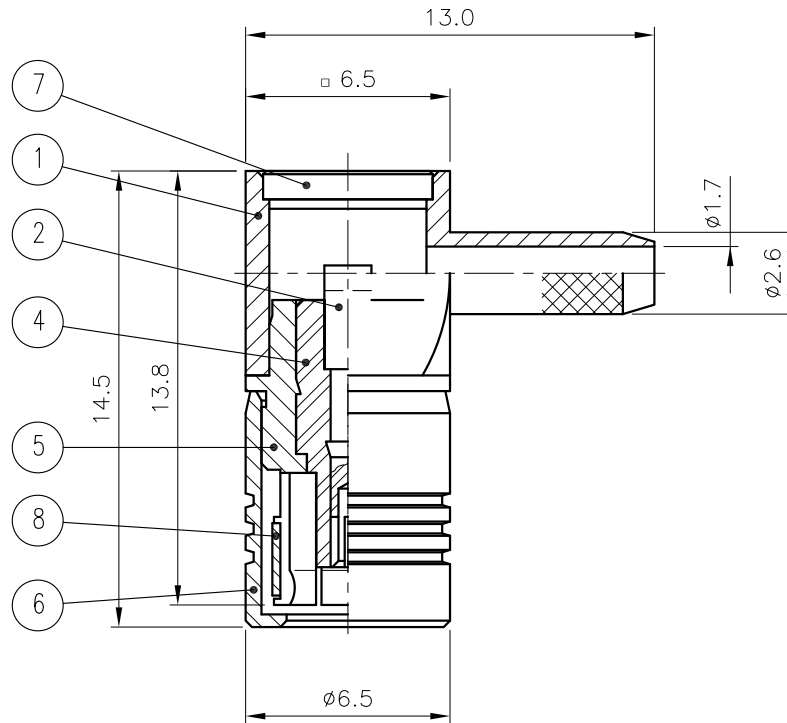
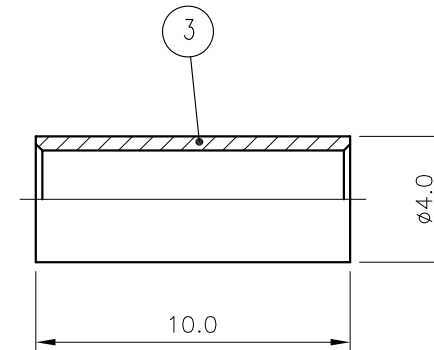




REVISION				
REV	DESCRIPTION	DRAWN	APPR	DATE
IR	Initial Registration			2000.09.09.
1	[설번No.201807-0002] 조립성 개선으로 인한 바디 나사채결→역지끼움 변경	S.Y.EUN	I.C.KIM	2018.07.05.
2	MIL-SPEC 도금사양 반영	S.Y.EUN	I.C.KIM	2019.01.08.



■ 조립 주의 사항

-CABLE 삽입부 내경 $\phi 1.7$ 후가공 가공여부 확인후 조립할것

주 기

1. 재질

- 1.1 몸체 : 구리 및 구리합금 봉, KS D 5101 C3604BD-F 과삭황동봉
- 1.2 접촉핀 : ASTM-B196의 C17300, 베릴륨동
- 1.3 절연체 : SAE-AS1946또는 동등한 재료 (PTFE 테프론)

2. 보호피막처리 : 접촉핀은 MIL-DTL-45204, type II, class I

몸체는 MIL-DTL-45204, type II, class 00 에 따라 처리 할 것

3. 전기적특성

- 3.1 특성 임피던스 : 50 Ω
- 3.2 절연저항 : 1,000M Ω 이상
- 3.3 접촉저항 : 6.0m Ω 이하
- 3.4 D.W.V : AC 750Vrms 이상에서 1분간 견딜 것

4. 모든 덧살 및 날카로운 모서리를 제거할 것.

5. 모든 치수는 참고치수임.

6. 관련도면 : 50085244

50085306
50085307
50085308
50085334
50085382
50085389

8	SPRING RING	1	BeCu C17300	Gold Plate	DSR00004-5/1
7	COVER	1	MBsBD C3604BD-F	산무 Gold Plate	DCO00036-5/2
6	CAP	1	MBsBD C3604BD-F	산무 Gold Plate	DCU00023-5/2
5	JACK	1	MBsBD C3604BD-F	산무 Gold Plate	DJA00034-5/3 DJA00034-5/2
4	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00342-N/1
3	FERRULE	1	MBsBD C3604BD-F	Gold Plate	DFE00031-5/1
2	CONTACT	1	BeCu C17300	Gold Plate 1.27 μ m	DCT00358-5/2 DCT00358-5/1
1	BODY	1	MBsBD C3604BD-F	산무 Gold Plate 0.508 μ m	DBD00451-5/4 DBD00451-5/1
NO.	DESCRIPTION	Q'TY	MATERIAL	PLATING	CODE

TOLERANCE	Decimal ± 0.2	DATE 2019. 01. 08.		 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017
	Angle $\pm 1^{\circ}$	APPROVED BY	I.C.KIM	
MATERIAL		CHECKED BY		TITLE SMB50 CABLE PL RG316
FINISH		DRAWN BY	S.Y.EUN	
SCALE 4/1		UNIT mm		A4 DWG NO. CN00207-7/1(K315-141-000) REVISION 2 SHEET 1 of 1